



2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月2日

上場会社名 株式会社 東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729 URL <https://www.accretech.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長COO (氏名) 木村 龍一

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長CFO (氏名) 川村 浩一

TEL 042-642-1701

四半期報告書提出予定日 2023年11月7日

配当支払開始予定日

2023年12月11日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	63,537	10.6	11,389	27.4	12,072	27.1	8,548	28.2
2023年3月期第2四半期	71,076	16.1	15,685	21.6	16,561	27.7	11,908	24.0

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 9,829百万円 (27.0%) 2023年3月期第2四半期 13,462百万円 (34.0%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	212.17	209.91
2023年3月期第2四半期	292.86	290.07

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	205,524	150,533	72.3
2023年3月期	209,032	146,028	69.0

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 148,644百万円 2023年3月期 144,288百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		109.00		126.00	235.00
2024年3月期		89.00			
2024年3月期(予想)				89.00	178.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	132,000	10.1	24,500	29.0	25,400	28.0	17,800	24.7	441.44

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期2Q	42,059,381 株	2023年3月期	41,903,281 株
期末自己株式数	2024年3月期2Q	1,704,712 株	2023年3月期	1,529,552 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期2Q	40,290,807 株	2023年3月期2Q	40,664,177 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっては、添付資料1「当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予想情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(会計方針の変更)	10
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米欧において高インフレとその抑制策としての高金利が継続した一方、中国では不動産部門の調整長期化などにより景気減速感が強まるなど、全般に景気の停滞感が強まる展開となりました。

このような状況下、当社を取り巻く環境は、半導体製造装置部門の取引先である半導体やハイテク関連企業においては、民生エレクトロニクス需要の低迷継続による慎重な投資姿勢が続きました。計測機器部門の取引先である多種多様なものづくり業界においても、マクロ経済の不透明感を主因に、投資判断を先送りする傾向が強まりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、受注高 595 億 9 百万円（前年同期比 25.8%減）、売上高 635 億 37 百万円（前年同期比 10.6%減）となり、利益面では、営業利益 113 億 89 百万円（前年同期比 27.4%減）、経常利益 120 億 72 百万円（前年同期比 27.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 85 億 48 百万円（前年同期比 28.2%減）となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメント別概況は以下の通りです。

【半導体製造装置部門】

半導体製造装置部門では、スマホ、PC、テレビなどの民生エレクトロニクス製品の低迷が続き、関連する半導体、電子部品などに向けた装置需要が引き続き低調に推移し、受注高は前年同期比で減少しました。そのような中で、SiC などのパワー半導体向けや、中国における各種半導体向け需要は引き続き堅調だったことに加え、生成 AI 関連の需要も新たに創出され、当社受注の下支えとなりました。

生産・出荷については、引き続き高水準の受注残を背景に、一部顧客の納期延伸要請に対する調整を行いつつ、概ね計画通りの出荷額を維持することができました。これにより、売上高は前年同期比で減少しましたが、引き続き高い水準を維持しました。なお、当期に飯能新工場が竣工しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における当部門の受注高は 423 億 3 百万円（前年同期比 30.8%減）、売上高 469 億 64 百万円（前年同期比 15.2%減）、営業利益は 92 億 98 百万円（前年同期比 33.2%減）となりました。

【計測機器部門】

計測機器部門では、EVの開発需要や、二次電池用の充放電試験装置の需要に動きがみられましたが、マクロ経済の不透明感や中国などでの景気後退により、主要業界で設備投資の先送りの傾向が強まったことから、受注高は前年同期比で減少しました。

生産・出荷については計画通り進めることができ、売上高は前年同期比で増加しました。

この結果、当部門における当第2四半期連結累計期間の受注高は172億6百万円(前年同期比9.6%減)、売上高165億73百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益は20億90百万円(前年同期比18.7%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

【資産、負債及び純資産の状況】

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ35億8百万円減少し、2,055億24百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少119億26百万円、製品、原材料、仕掛品などの棚卸資産の増加95億46百万円、有形固定資産の増加45億79百万円、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権の減少29億61百万円等です。

当第2四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ80億12百万円減少し、549億91百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少34億91百万円、未払法人税等の減少30億34百万円、借入金の減少20億円等です。

当第2四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ45億4百万円増加し、1,505億33百万円となりました。自己資本比率は、72.3%となりました。

【キャッシュ・フローの状況】

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ119億27百万円減少し、281億8百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億32百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益120億83百万円、棚卸資産の増加92億94百万円、法人税等の支払額56億42百万円、仕入債務の減少43億97百万円、売上債権の減少38億91百万円、減価償却費21億円等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、64億98百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出60億65百万円、無形固定資産の取得による支出6億97百万円等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、78億21百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払額50億87百万円、長期借入金の返済による支出20億円等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体製造装置部門では、民生エレクトロニクス製品需要の低迷が当面続く見込みではあるものの、SiCなどのパワー半導体需要、生成AIに関連した需要などが期待されます。

一方で、計測機器部門は、マクロ経済の不透明感から、顧客全般で設備投資が先送りされる傾向が当面続くものと想定しております。

以上を踏まえ、2023年5月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正(半導体関連を上方修正、計測関連を下方修正)することといたします。

(2024年3月期通期)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 129,000	百万円 24,000	百万円 24,000	百万円 17,000	円 銭 422.82
今回修正予想(B)	132,000	24,500	25,400	17,800	441.44
増減額(B - A)	3,000	500	1,400	800	—
増減率	2.3%	2.1%	5.8%	4.7%	—
前年実績 (2023年3月期)	146,801	34,494	35,297	23,630	581.33

(注) 業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,080	28,154
受取手形、売掛金及び契約資産	36,401	33,200
電子記録債権	7,002	7,242
商品及び製品	2,462	2,628
仕掛品	32,862	37,205
原材料及び貯蔵品	18,156	23,195
その他	7,063	3,993
貸倒引当金	△ 57	△ 50
流動資産合計	143,972	135,570
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	16,624	28,420
その他(純額)	32,329	25,113
有形固定資産合計	48,954	53,534
無形固定資産		
のれん	279	280
その他	3,672	4,005
無形固定資産合計	3,951	4,285
投資その他の資産		
その他	12,267	12,246
貸倒引当金	△ 112	△ 112
投資その他の資産合計	12,154	12,134
固定資産合計	65,060	69,954
資産合計	209,032	205,524

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,164	9,091
電子記録債務	12,194	9,776
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	4,000	3,000
未払法人税等	6,324	3,289
契約負債	8,703	9,245
賞与引当金	2,636	2,743
役員賞与引当金	9	85
その他	5,615	5,304
流動負債合計	50,947	43,836
固定負債		
長期借入金	8,000	7,000
役員退職慰労引当金	57	51
退職給付に係る負債	1,248	1,294
訴訟損失引当金	1,914	1,914
資産除去債務	65	103
その他	771	791
固定負債合計	12,057	11,155
負債合計	63,004	54,991
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,064	11,350
資本剰余金	22,179	22,496
利益剰余金	114,005	117,463
自己株式	△ 7,098	△ 7,980
株主資本合計	140,150	143,330
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	510	794
為替換算調整勘定	2,619	3,596
退職給付に係る調整累計額	1,007	923
その他の包括利益累計額合計	4,137	5,313
新株予約権	1,072	1,115
非支配株主持分	668	773
純資産合計	146,028	150,533
負債純資産合計	209,032	205,524

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)
売上高	71,076	63,537
売上原価	41,724	37,802
売上総利益	29,351	25,735
販売費及び一般管理費	13,666	14,345
営業利益	15,685	11,389
営業外収益		
受取利息	16	22
受取配当金	53	35
為替差益	388	449
投資事業組合運用益	172	101
受取補償金	188	16
その他	101	184
営業外収益合計	920	809
営業外費用		
支払利息	19	50
固定資産除売却損	0	60
輸送事故による損失	14	-
その他	9	16
営業外費用合計	44	126
経常利益	16,561	12,072
特別利益		
新株予約権戻入益	5	6
投資有価証券売却益	-	19
関係会社清算益	58	-
特別利益合計	64	26
特別損失		
割増退職金	-	14
特別損失合計	-	14
税金等調整前四半期純利益	16,626	12,083
法人税、住民税及び事業税	4,751	3,122
法人税等調整額	△71	333
法人税等合計	4,679	3,455
四半期純利益	11,947	8,628
非支配株主に帰属する四半期純利益	38	79
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,908	8,548

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	11,947	8,628
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33	284
為替換算調整勘定	1,518	1,001
退職給付に係る調整額	△ 36	△ 84
その他の包括利益合計	1,515	1,201
四半期包括利益	13,462	9,829
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,387	9,724
非支配株主に係る四半期包括利益	74	105

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	16,626	12,083
減価償却費	1,798	2,100
のれん償却額	20	22
株式報酬費用	136	259
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	53	53
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	5	△ 5
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	△ 11
受取利息及び受取配当金	△ 69	△ 58
支払利息	19	50
投資事業組合運用損益(△は益)	△ 172	△ 101
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△ 19
関係会社清算益	△ 58	-
売上債権の増減額(△は増加)	△ 4,084	3,891
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,563	△ 9,294
仕入債務の増減額(△は減少)	113	△ 4,397
契約負債の増減額(△は減少)	45	383
その他	1,703	2,508
小計	9,575	7,465
利息及び配当金の受取額	70	58
利息の支払額	△ 18	△ 48
法人税等の支払額	△ 5,016	△ 5,642
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,611	1,832
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△ 29	△ 30
定期預金の払戻による収入	10	30
有形固定資産の取得による支出	△ 4,903	△ 6,065
有形固定資産の売却による収入	6	75
無形固定資産の取得による支出	△ 151	△ 697
のれんの取得による支出	△ 77	-
投資有価証券の取得による支出	△ 1	△ 1
投資有価証券の売却による収入	-	57
投資事業組合への出資による支出	△ 7	△ 24
投資事業組合からの分配による収入	320	154
関係会社清算による収入	79	-
貸付けによる支出	△ 1	△ 0
貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	△ 50	△ 4
敷金及び保証金の回収による収入	3	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,803	△ 6,498
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△ 1,000	△ 2,000
リース債務の返済による支出	△ 84	△ 177
ストックオプションの行使による収入	69	362
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 919
配当金の支払額	△ 4,105	△ 5,087
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,120	△ 7,821
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,055	559
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 4,256	△ 11,927
現金及び現金同等物の期首残高	49,006	40,036
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,749	28,108

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(1) 自己株式の取得

当社は、2023年2月6日開催の取締役会決議に基づき、当第2 四半期連結累計期間に自己株式182,400株の取得を行いました。単元未満株式の買取による取得も含め、当第2 四半期連結累計期間において自己株式が919百万円増加しました。

なお、当該決議に基づく自己株式の取得は、2023年4月28日をもって終了しています。

(2) 自己株式の処分

当社は、2023年7月5日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式7,940株を処分いたしました。この処分により、当第2 四半期連結累計期間において、自己株式が37百万円減少いたしました。

この結果、当第2 四半期連結会計期間末において自己株式が7,980百万円になりました。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前第2 四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	55,400	15,675	71,076
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	55,400	15,675	71,076
セグメント利益	13,923	1,762	15,685

当第2 四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	46,964	16,573	63,537
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	46,964	16,573	63,537
セグメント利益	9,298	2,090	11,389

(注)セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。